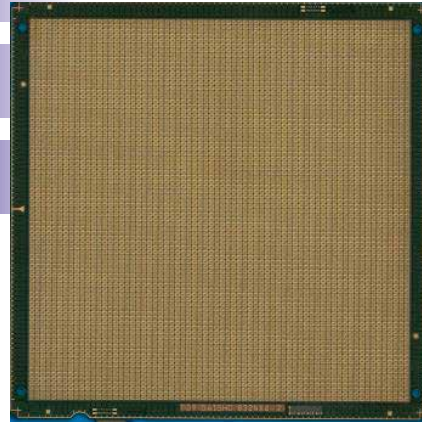


# Organic Device (SAW Device)

Switching to Organic (Printed Circuit Board)

Enables to replace from [HTCC, LTCC]

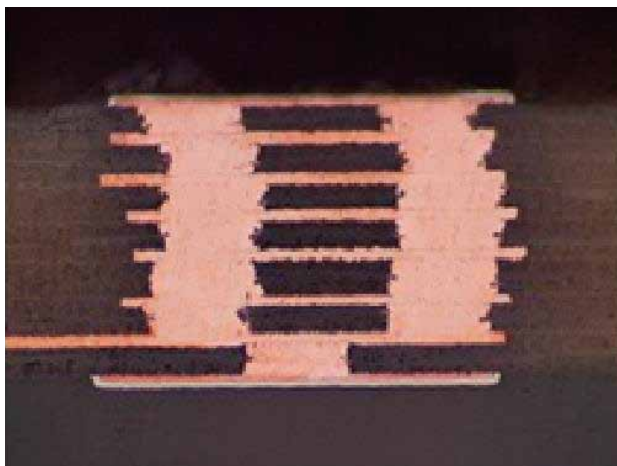
Proposal to [higher performance], [Reduce cost]



Comparison	L/S (um)	Trace (Property)	Multi layer	Cost	Initial cost	Quality Assurance
Ceramic (HTCC)	× 50/50um min	× Tungsten	× 3layer	× High	× Punching die required	× No O/S tested
PCB	○ Approx.3 0/40um	○ Copper	○ 4~8layer	○ Reason able	○ No punching die required	○ O/S test

■ Laser via land size: 90um

■ Surface finish: Flash gold, Ni/Pd/Au, Electrolytic Ni/Au



8L Coreless

## Example of adopted organic board size

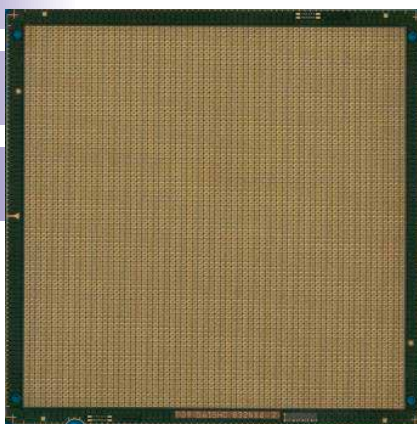
- 0.9×1.1mm 2~4L/Buildup
- 1.1×1.4mm 4~6L/Buildup
- 1.4×1.8mm 4~9L/Buildup or coreless
- 1.6×2.0mm 4~8L/Buildup
- 2.0×2.5mm 4~6L/Buildup

# Organic Device (SAW Device)

「有機化(PCB化)」で

「HTCC・LTCCから置換可能!」

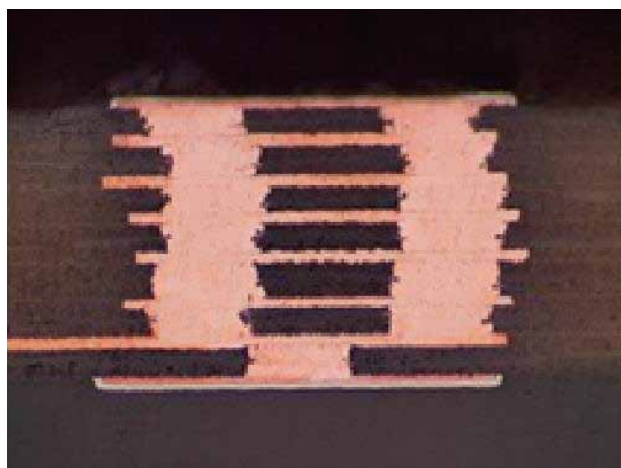
「特性UP」「コスト低減」のご提案



比較表	L/S (um)	パターン (特性)	多層化	価格	イニシャルコスト	品質保証
セラミック (HTCC)	×50/50 まで	×タングステン	×3層	×高価	×金型必須	×テスター不可
PCB	○30/40 程度	○銅	○4~8層	○安価	○金型不要	○テスター可

■LVHランド径:φ90um

■表面処理:フラッシュ金・NiPdAu・電解金



8L Coreless

## 有機化ご採用実績サイズ

- 0.9×1.1mm 2~4L/Buildup
- 1.1×1.4mm 4~6L/Buildup
- 1.4×1.8mm 4~9L/Buildup or coreless
- 1.6×2.0mm 4~8L/Buildup
- 2.0×2.5mm 4~6L/Buildup